

YDIV13-0618SC1

6-18GHz功分器 数据手册



四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品简介

YDIV13-0618SC1 型 GaAs 单片集成 0 度功分器，在 6~18GHz 的频率范围具有较低的插损和优良的端口驻波特性，非常适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块。

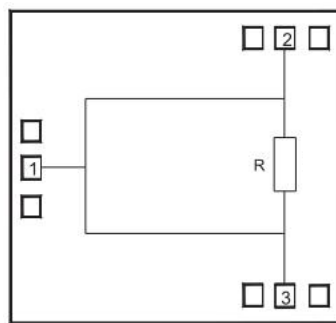
该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 工作频段：6 to 18 GHz
- 插入损耗：0.8 dB
- 芯片尺寸：1mm x 0.8mm

应用领域

- 微波无线电
- 测试测量
- RF/微波电路
- 仪器仪表
- 军事和航天



YDIV13-0618SC1 功能框图



极限参数

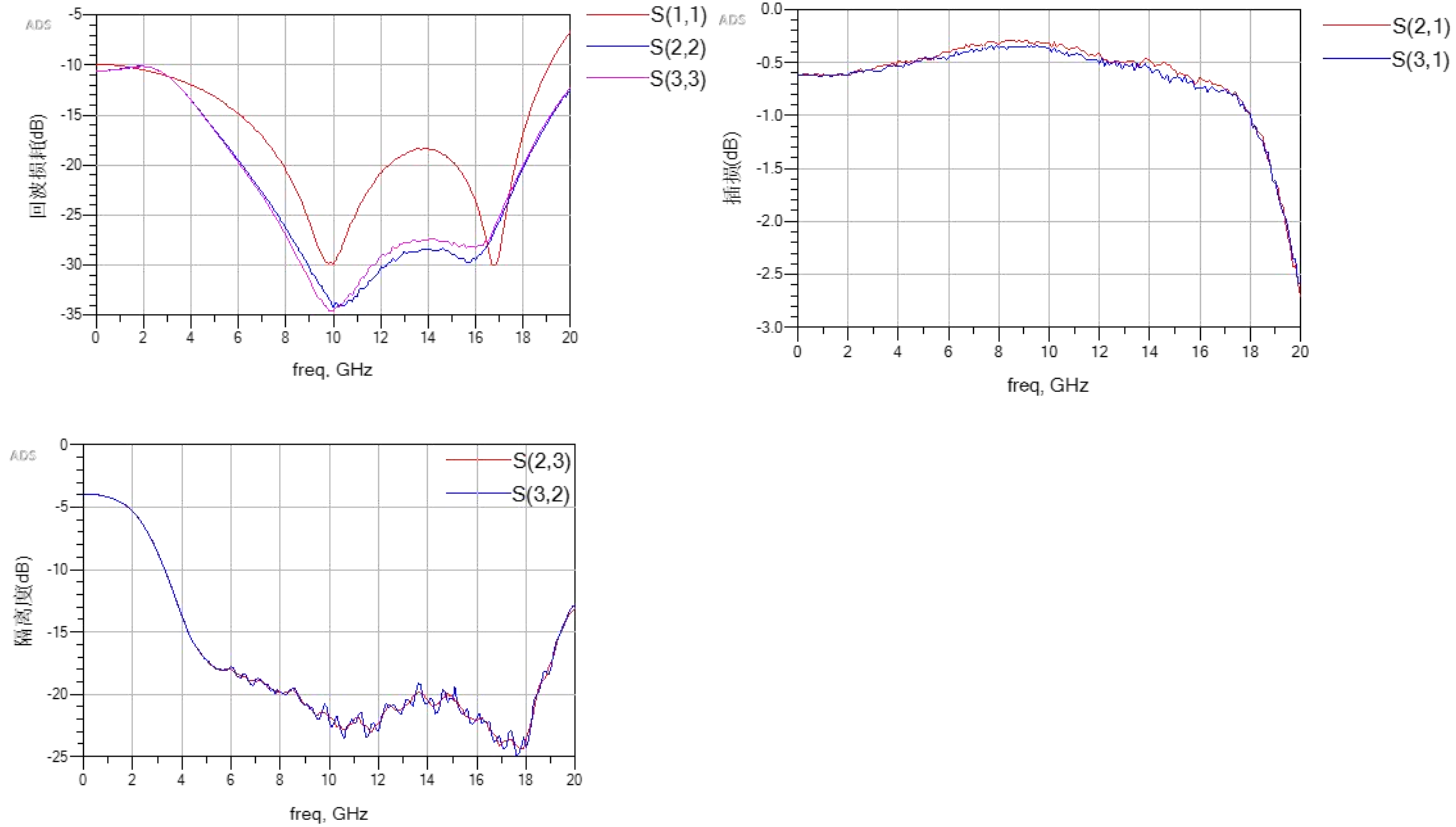
储存温度	-65 ~ +150°C
工作温度	-55 ~ +125°C
结温	175°C
静电防护等级 (HBM)	Class1A

注意：高功率应用时，请采用共晶烧结工艺安装芯片。

电性能表 (T_A=+25°C, 50 system)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	6- 18			GHz
输入驻波比	-	1.4	-	-
输出驻波比	-	1.3	-	-
插入损耗	-	0.8	-	dB
隔离度	-	17	-	dB

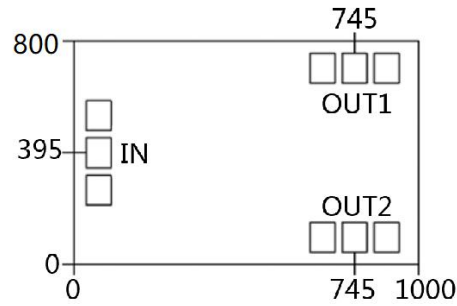
测试曲线



键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	IN	RF 输入端口, 阻抗 50
2、3	OUT1, OUT2	RF 输出端口, 阻抗 50
	GND	芯片背面必须接地

外形尺寸



说明:

1. 单位: 微米
2. 芯片背面镀金
3. 芯片背面接地
4. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100x100 (um)
5. 不能再通孔上进行键合
6. 外形尺寸公差: $\pm 50\mu\text{m}$

推荐装配图

